



8440

Chip-Cards

Produkt Information

40µm transluzentes HAF Klebeband

Produktbeschreibung

tesa® HAF 8440 ist eine trägerlose hitzeaktivierbare Folie auf Basis nichtreaktiver, thermoplastischer Copolyamide.

Produktmerkmale

- Reliable chip module bonding
- Suitable for PVC, ABS and PC cards
- Good workability on all common implanting lines
- Good ageing resistance
- Invisible on assembled card

Anwendung

tesa HAF® 8440 ist zur Implantierung von Chip-Modulen in Smart Cards aus PVC und ABS.

- Einsetzbar für Karten aus PVC, ABS, PET.
- Gut zu verarbeiten auf allen gängigen Implantierungsmaschinen.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|------------|---------------------|-------------|
| • Trägermaterial | ohne | • Art der Abdeckung | Trennpapier |
| • Klebmasse | Copolyamid | • Dicke | 40 µm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | |
|---------------------|----------------------|
| • Verbundfestigkeit | 12 N/mm ² |
|---------------------|----------------------|

Weitere Informationen

Lagerbedingungen gemäß tesa HAF® Haltbarkeitskonzept.

Technische Empfehlungen:

Die folgenden Werte stellen nur eine Empfehlung zur Einstellung an der Verarbeitungsmaschine dar. Die genauen Parameter sind abhängig von Maschinentyp, verwendeten Materialien, Kundenanforderungen etc. und müssen deshalb gesondert überprüft werden.

- Konfektionierung:

tesa® HAF 8440 wird auf den Modulgurt laminiert. Das kann sowohl inline wie auch offline geschehen. Das Konfektionieren hat keinen Einfluß auf die Haltbarkeit des Klebebandes. Ausgerüstete Modulgurte können genauso lange gelagert werden wie das Klebeband selbst.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=08440>



8440 Chip-Cards

Produkt Information

Weitere Informationen

Empfohlene Einstellungen:

Temperatur¹: 130°C - 140°C

Druck: 65 N/Modul

Zeit: 1,5 - 3,0 sec.

- Implementierung:

Für das Einsetzen des Chips werden die vorausgerüsteten Module aus dem Modulband ausgestanzt, positioniert und unter Hitze in die Vertiefung des Kartenkörpers eingesetzt. Die genauen Parameter sind auch hier abhängig vom verwendeten Material, Maschinentyp etc.. Folgende Parameter haben sich in der Praxis bewährt:

Temperatur¹: 130° - 190°C

Zeit: 0,7 - 2,0 sec.

Druck: 65 N/Modul

¹ Temperatur gemessen am Stempel

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=08440>